



RE225-HP

- Carta in resina fenolica FR2 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Protezione organica per superfici (OSP)
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 35 x 42 rilievi di saldatura 2,10 mm Ø
- Diametro del foro 1,00 mm
- Attacco per connettore D-Sub DIN 41652 2 x 25 poli
- 2 percorsi potenziali
- Dimensioni 100 x 160 mm